

# 第29回若手研究会セミナー

## 【半導体後工程の基礎と最新の技術動向】

～日本半導体の復活を願いつつ振り返る半導体後工程の基礎と世界の最新技術動向～（仮題）

**2023年6月9日（金） 13:00～17:00**

開催方式：現地参加&オンライン視聴

現地：大阪公立大学I-siteなんば2階 定員 50名

URL:<https://www.omu.ac.jp/bsite/>

オンライン参加(ZOOMウェビナー)：100名

講師：産業技術総合研究所 総括研究主幹

### 高橋 健司 氏

講演概要：半導体デバイスの後工程（パッケージング工程）は半導体のチップを保護し、比較的大きなピンを基板に挿入実装するものであった。しかし、電子機器の小型・高密度化、さらには性能向上を図るために後工程技術は飛躍的な変貌を遂げた。トランジスタ性能の限界が語られる現在、前工程と後工程の境界は曖昧になり、従来の概念を越える後工程技術が要求されている。過去から現在、将来を踏まえた後工程技術の要点を概説する。

講師：AZ Supply Chain Solutions 代表

### 亀和田 忠司 氏

講演概要：日本半導体の復活の話題で賑やかで、日本の強みは材料・化学・装置・人材と語られる事が多い。国外からの様々な視点では、日本の真の強みとは何なのか、豊富な国際的観点から日本の強みを概説する。

# プログラム

(若干時間が前後することがあります、また、タイトルは仮題です)

13:00~13:10 開催の挨拶

13:10~14:10

半導体後工程の歴史とその進展 (高橋氏)

14:10~14:25 休憩

14:25~15:25

半導体後工程の進化と将来展望 (高橋氏)

15:25~15:40 休憩

15:40~16:55

最新の世界的な技術動向と国外から眺めた日本の強み  
(亀和田氏)

16:55~17:00 閉会

\* 定員150名(先着申込順)

\* 参加費「クーポン利用可：1名/枚」

会員/賛助会員/協賛学会会員：3,000円 シニア会員：  
2,000円 非会員：5,000円

学生会員：無料, 一般学生：1,000円

\* 申し込みは、下記からお願いします。(締切：5月31日迄)

## 参加申し込み

・この機にエレクトロニクス実装学会への入会を希望される方は、  
下記URLから登録をお願いします。

<https://service.kktcs.co.jp/smms2/entry/jiep>

申し込み後に会員番号、PWが送付されますので、会員登録後  
お申込みください。

問合せ：エレクトロニクス実装学会関西支部事務局

info@jiep.or.jpにご送付ください。